

博敏电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年9月19日（周二）下午 15:45~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长/总经理徐缓 2、财务总监刘远程 3、副总经理/董事会秘书黄晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、希望公司采取强力措施，维护市场形象？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司业绩波动受宏观经济形势错综复杂，通胀与通缩并存，需求不足，行业产能过剩情况加剧，行业竞争激烈等影响。2023年半年度业绩虽同比下滑，但公司二季度经营情况环比一季度呈现向好趋势。公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售起家，不断通过内生发展与外延并购相结合的方式，以 PCB 为内核，从横向和纵向两个维度进行业务延伸（PCB+），持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品的研发与开拓力度，形成了“主营业务+创新业务”的模式。其中公司 PCB 事业部战略性聚焦“电源/储能、数据通信、汽车电子、智能终端”四大领域，以“陶瓷基板、特色产品、数连产品”树差异，将 PCB 业务内核持续向高质量、高</p>

价值领域延伸。未来随着下游需求恢复，公司产品也将顺应产业发展趋势逐步释放扩产产能，进一步提升公司在 PCB 和陶瓷衬板的行业地位。感谢您的提问！

2、贵公司自上市解禁以来，公司高管，股东逐年减持公司股份，让长期投资者何以心安？今年下半年以来，证监会严格规范减持行为，为响应政策，已有近百家上市公司股东提前终止减持，更有上百家实施回购或号召股东增持，建议贵公司也响应号召，组织公司股东，高管增持，以提升长期投资者信心，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司将密切关注股价走势，必要时将采取维稳措施，感谢您的关注！

3、公司究竟有没供货给华为？或有没进入华为产品的产业链？如有，那是华为哪方面的产品领域？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务重点形成了新能源/汽车电子、数据/通讯、智能终端、工控安防等高科技领域的优秀企业客户群体，包括三星电子、Jabil、歌尔股份、比亚迪、华为技术、利亚德、富士康、联想、海信、长城计算机、日海物联、华勤电子、科大讯飞、欧司朗、美律电子和天马微电子等优质行业客户，华为技术为其中之一，相关业务合作可查阅公司披露的相关公告。后续如有最新的合作意向或者合作计划，公司亦会按照信息披露规范指引要求及时披露。谢谢！

4、请问公司现在生产经营是否满负荷运转？公司新业务方面进展如何？如何看待今年股价走势“？是否有信心带领公司股价提升？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续做好客户开发及深耕工作，采取多项措施以确保安全稳定运营和维护供应链稳定，不断优化公司运营策略和提升生产经营效率，客户订单的交付正在有序进行中。AMB 新业务方面，公司上半年持续拓展新客户并积

极参与客户的招投标工作，目前取得良好进展，通过了多家客户的认证且获得订单，预计将于下半年开始生产交付。新开拓的客户包括第三代半导体头部企业、海外车企供应链客户等，前期开拓的客户订单如期交付，我们亦在保供同时持续推进国内外其他标杆客户订单的落地、放量；IC 载板新业务方面，伴随着江苏博敏二期智能工厂的投产及产能爬坡，在原有 tenting 工艺封装载板产品线基础上，投资新增的首条高端细线路 mSAP 工艺封装载板和无芯板工艺进入运营阶段，标志着公司正式具备涉足中高端 IC 封装载板领域的的能力，并实现向 FC 类载板的技术转型。公司 IC 封装载板产品线达产后产能约 1 万平米/月，产品类型涵盖 Module、BOC、PBGA、WBCSP、FCCSP 等，产品主要应用于数据存储、微机电控制、光电显示和无线射频等领域，其中 EMMC、MEMS、DRAM、Module 等存储类产品已配合多家封测类客户进入小批量生产阶段，SD/microSD 等产品送样认证中。目前客户导入进程顺利，已为包括终端方案设计公司、封测公司在内的十多家客户进行打样试产，个别型号已进入量产阶段。目前公司经营管理正常、战略目标明确，各公司业务拓展顺利。公司保持努力做好经营管理和以较好的业绩回报投资者的初心不变。同时，公司也密切关注着二级市场股价，也将不断加强与投资者的沟通和关注资本市场的情况，科学有效地传递公司内在价值，提振各方信心，必要时候将进行相关的维稳措施。感谢您的关注。

5、华为 MATE60 手机横空出现，有可不可忽视的环节 4000+ 电路板的反复换板开发，期待公司主动锲而不舍的成为华为公司重要伙伴？

答：尊敬的投资者，您好。公司已回复过类似问题，敬请参阅问题 3 的回复，感谢您的提问！

6、公司有否信心让股价创上市以来的新高？公司信心直接

影响投资者的信心，市场上股价定位很重要因素，就是公司超群的想象力和不断开拓创新能力！？

答：尊敬的投资者，您好！公司二级市场股价受宏观环境、资本市场环境、行业估值水平等诸多因素的影响而有所波动。公司两大事业部共同实施“PCB+元器件+解决方案”上下游一体化发展战略，将 PCB 业务内核不断向外延拓展（PCB+），打造差异化竞争的护城河。目前公司经营管理正常、战略目标明确，各公司业务拓展顺利。公司保持努力做好经营管理和以较好的业绩回报投资者的初心不变。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。未来公司将聚焦价值创造和股东利益最大化，进而回馈广大投资者。同时，公司也密切关注着二级市场股价，也将不断加强与投资者的沟通和关注资本市场的情况，科学有效地传递公司内在价值，提振各方信心，必要时候将进行相关的维稳措施。感谢关注。

7、公司在 6G 方面，有没在进行产品研发了？同行很多上市公司都已经告知在进行了。难道公司打算慢人一步？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕数通赛道多年，从 2G 起步发展到 5G，涵盖通信、服务器/存储器、天线基站等相关产品，在数通领域拥有较好的技术储备和客户基础。第六代移动通信（6G）网络技术作为 5G 技术的迭代，PCB 企业均会为下一代技术提前做好相关技术储备，但目前尚处于探索研究阶段。2023 上半年，公司研发费用为 6392.20 万元，占营业收入比例为 4.22%，主要投向 5G 通信、大功率新能源、服务器、陶瓷衬板、IC 载板、高阶 MiniLED 等。6G 作为未来 PCB 需求增长的新方向之一，公司将持续关注行业发展动态，结合市场需求和自身业务优势研发新技术和新产品，不断满足客户需求。感谢您对公司的关注！

8、公司上市来抓住机会募资几十亿，给与充分发展机，这些资金投资项目是否体现“科技领先性”、“市场广阔性”和很

	<p>深的“护城河”？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司最近一次非公开发行 15 亿募集资金投资项目顺应了行业未来发展方向，满足 5G 通信、服务器、Mini LED、工控、新能源汽车、消费电子、存储器等应用领域对 PCB 产品的迭代需求，充分考虑了市场竞争格局，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应。同时募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司在高多层板、HDI 板以及 IC 载板等高端领域的出货占比，提升公司盈利能力的同时优化公司的资本结构，为后续业务发展提供有力保障。感谢您的提问！</p> <p>9、有目标、有理想、会拼就会赢，只要公司领导努力就有希望成为伟大公司，华为也是拼出来的！？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。感谢您的宝贵意见和支持！</p> <p>10、合肥项目具体投资人会什么时候确定？会设法引入华为公司投资吗？能否早日比计划提前开工？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司与合肥经济技术开发区管理委员会的合作顺利推进中，2023 年 6 月公司本次对外投资新设立的全资子公司合肥博睿智芯微电子有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照，注册资本 5 亿元，围绕集成电路设计、制造、销售以及特种陶瓷制品的制造、销售等开展经营业务。目前项目正在筹备可研和环评的相关工作，预计今年 Q4 开工建设。公司采取统一规划、分项实施的原则，预计该项目的主要资金来源为公司自有或自筹资金，包括引入政府推荐的资金及自身寻找的产业链上下游资金等。感谢您的提问！</p>
附件清单(如有)	不适用
日期	2023 年 9 月 19 日